

レーザ協会 第202回研究会**「新たなレーザアプリケーションと周辺技術」**

開催日時:令和7年5月21日(水) 14:30~17:00

会場:中央大学理工学部5号館1階5138号室
(東京都文京区春日1-13-27、最寄り駅:後樂園駅、春日駅、水道橋駅)

開催形式:対面形式



研究会主旨:レーザ光源の高効率化、発振波長域の拡大、短パルス化、さらには光学技術、加工技術の進歩により、レーザを用いた新たなアプリケーションの実用化が進んでいます。いずれのアプリケーションも従来工法に対する消費電力の削減や工程短縮、新たな加工システムの構築など、カーボンニュートラルに貢献する技術として期待されています。本研究会では「新たなレーザアプリケーションと周辺技術」と題し、レーザ発振器およびレーザ周辺技術、加工技術に関わる企業より3名の講師をお招きし、講演を予定しています。万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

14:30~14:35 **開会挨拶**

レーザ協会会長

14:35~15:20 **講演1**

「半導体レーザ加工によるカーボンニュートラルへの提案」

レーザーライン株式会社 皆川 邦彦氏

15:20~16:05 **講演2**

「レーザクリーニングによるカーボンニュートラルへの取組み」

東成エレクトロビーム株式会社 西原 啓三氏

16:05~16:50 **講演3**

「各種アプリケーションに対応した加工ヘッド~OPTICEL~のご紹介」

株式会社レーザックス 大江 浩史氏、小澤 健治氏

16:50~17:00 **閉会挨拶**

レーザ協会副会長

【参加費】 会員:無料 非会員:7,000円(ご案内の都合上5月15日までに銀行振込をお願いします)

【申込先】 レーザ協会ウェブページ <http://jslt.jp/> の申込みフォームよりお申し込み下さい。

・参加申込〆切:令和7年5月14日(水)

【問合せ先】 レーザ協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp